

# INTEL 1851 CPU Contact Frame V1

## High Performance Cooling Solutions – Made in Germany

Der Intel 1851 CPU Contact Frame V1 ersetzt den Stock-ILM des Mainboards und ermöglicht einen gleichmäßigen Anpressdruck der CPU im Sockel. Die Innenkontur des Frames wurde an die Prozessoren für den Sockel 1851 angepasst. Die Montage des Kontaktrahmens erfolgt beim Verschrauben ohne ein spezifisches Drehmoment und ist somit sehr anwenderfreundlich.

Der Intel 1851 CPU Contact Frame V1 schützt die CPU, wenn diese häufig montiert wird, und ermöglicht beim Extreme Overclocking nicht nur bessere Temperaturen, sondern auch eine stabile Taktrate des Arbeitsspeichers.

### Warum sollte man einen Contact Frame benutzen?

Der standardmäßige Integrated Loading Mechanism (ILM) verfügt über Kontaktpunkte, die in der Mitte der länglichen CPU liegen. Durch den dadurch entstehenden ungleichmäßigen Anpressdruck des Prozessors im Sockel wölbt sich die Oberfläche des Integrated Heatspreaders (IHS) konkav. Dadurch liegt die Bodenplatte des CPU-Kühlers in erster Linie an den Kanten des IHS auf, sodass der thermale „Hotspot“ der CPU nicht optimal abgedeckt ist.

Der Intel 1851 CPU Contact Frame V1 verfügt über eine spezielle Innenkontur, um bei der Montage den Anpressdruck von der Mitte der CPU auf die Kanten zu verlegen. Dadurch wird die konkave Wölbung des IHS vermieden. Dies führt dazu, dass CPU-Kühler besser auf dem Prozessor aufliegen und eine größere Kontaktfläche entsteht, um die Abwärme der CPU abzuführen. Durch den verschobenen thermischen Mittelpunkt der Arrow Lake-Prozessoren in das obere Drittel des Prozessors ist eine möglichst ebene Auflagefläche besonders wichtig.

Die Montage des Contact Frames ist sehr einfach und erfolgt in nur wenigen Schritten. Je nach verwendetem CPU-Kühler und abhängig von der verwendeten CPU können sich die Temperaturen des Prozessors spürbar verringern.



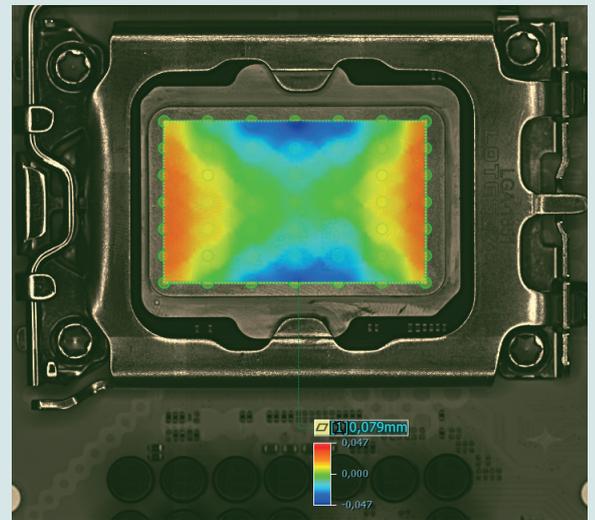
### Kurzinformationen

- Niedrigere CPU-Temperaturen
- Einfache Montage
- Hohe Kompatibilität
- Eloxiertes Aluminium

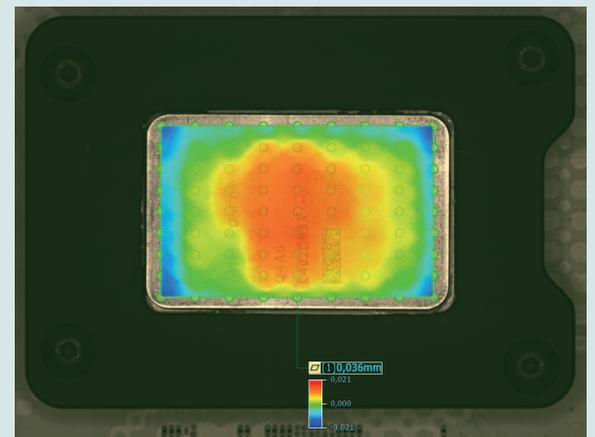
### Lieferumfang

- 1x CPU Contact Frame
- 4x Zylinderkopfschrauben UNC-Gewinde
- 1x Winkelschlüssel Innensechskant
- 1x Winkelschlüssel Torx

### mit ILM



### mit Intel 1851 CPU Contact Frame V1



## Technische Daten

Einheit:	Wert/Beschreibung:
Material:	Aluminium, eloxiert
Farbe:	Schwarz
Typische Anwendung:	CPU-Montagehilfe
Länge:	71 mm
Breite:	51 mm
Höhe:	6 mm
Verpackungsgröße:	21x15x3 cm
*Brutto Gewicht:	65 g
*Netto Gewicht:	21 g
Artikelnummer:	TG-CF-i1851-V1
EAN-Code:	4260711991103
VPE:	14 Stk.

\*Das Nettogewicht ist das Gesamtgewicht eines Artikels abzüglich des Gewichts der Verpackung und des Zubehörs. Das Bruttogewicht bezieht sich auf das Gesamtgewicht des Produktes inklusive Zubehör und Verpackung. Geringe Gewichtsabweichungen sind produktionsbedingt möglich.

## Kompatibilitätshinweise

Während eines XOC-Events in Taipeh, Taiwan, das Ende September 2024 als Pre-Launch-Event von ASUS ausgerichtet wurde, kam der Intel 1851 CPU Contact Frame V1 bereits teilweise zum Einsatz. Das renommierte Team von Overclocked Gaming Systems (OGS) aus Griechenland konnte mit dem Intel 1851 CPU Contact Frame V1 konsistent 33-50 MHz mehr an Taktrate im Einsatz mit flüssigem Stickstoff (LN2) erzielen.

*„The Thermal Grizzly 1851 Contact Frame helped us to gain 33-50 MHz every time we switched from Intel Stock ILM to the Contact Frame.“  
Team OGS*

Im alltäglichen Gebrauch können auf einem Mainboard mit dem herkömmlichen Integrated Loading Mechanism (ILM) Temperaturverbesserungen von 0 bis 6 Grad Celsius erzielt werden, wenn der ILM durch einen Intel 1851 CPU Contact Frame V1 ausgetauscht wird. Wenn der Reduced Load ILM (RL-ILM), der bei einigen Socket-1851-Mainboards verwendet wird, ersetzt wird, können mit dem Intel 1851 CPU Contact Frame V1 noch bis zu 3 °C niedrigere Temperaturen ermöglicht werden.

## Kompatibilitätshinweise

Der Intel 1851 CPU Contact Frame V1 ist mit Prozessoren der Intel Core Ultra 200-Serie für den Socket LGA1851 kompatibel. Zusätzlich ist der Frame nur mit CPUs kompatibel, deren Integrated Heatspreader (IHS) um nicht mehr als 0,2 Millimeter abgeschliffen wurde. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass sich keine elektronischen Bauteile unter dem Frame befinden. Dies ist besonders bei Mainboards mit dem Mini-ITX-Formfaktor zu beachten.

## Markeninformation

Thermal Grizzly ist eine eingetragene Marke.

## Zur Beachtung

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Unsere Empfehlungen entbinden nicht von der Verpflichtung, das Problem der evtl. Verletzung von Schutzrechten Dritter selbst zu überprüfen und ggf. auszuräumen. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Druckfehler sind vorbehalten.